平成 25 年 11 月 26 日

各　位

会 社 名　株 式 会 社 石 井 表 記
代表者名　代表取締役　石 井　峯 夫
（コード番号　６３３６　東証第２部）
問合せ先　執 行 役 員 開発本部長　小 沢　康 博
（ＴＥＬ　０８４－９６０－１２３１）

世界初、ＷＬＰ・バンプ向けインクジェットコーターを共同開発

株式会社テラプローブと株式会社石井表記は、ウエハレベルパッケージ（ＷＬＰ）とバンプ向けに、厚膜絶縁塗布材料（ポリイミド）をインクジェット方式で塗布するインクジェットコーターを、半導体業界では世界で初めて共同開発いたしました。

従来、ＷＬＰやバンプ製造工程における絶縁膜塗布工程はスピンコーターでの塗布が主流でした。
今回共同開発したインクジェットコーターは、対象ウエハに超微小化した絶縁材料を直接吹き付けることにより、同じ材料で膜厚を容易に変更することを可能としました。
更に従来のスピンコーターでは不可欠な洗浄工程が不要となり、高い生産性を実現しております。

当インクジェットコーターの主な特徴は以下のとおりです。

１．従来のスピンコーターで使用しているポリイミド材を共用でき、高品質、高効率の塗布が可能。
２．200～300㎜ウエハに対応し、膜厚をフレキシブルに調整することが可能。
３．凹凸の大きい再配線表面にも塗布が容易で、均一性にも優れている。

当社は、インクジェットコーターの特徴を活かした薄膜から厚膜までの塗布技術を、既存装置および将来装置へ継続的に技術革新を行い、独創性のある装置作りで半導体業界のＷＬＰプロセスおよびその他のプロセスを世界へ向け提供してまいります。

以　上